

Title (en)
METHOD FOR SELECTIVELY COATING NON-CONDUCTORS WITH CARBON PARTICLES AND USE OF COPPER CONTAINING SOLUTIONS THEREIN.

Title (de)
VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN BESCHICHTUNG VON NICHTLEITERN MIT KOHLENSTOFF-PARTIKELN UND DIE VERWENDUNG VON KUPFERHALTIGEN LÖSUNGEN IM VERFAHREN.

Title (fr)
PROCEDE DE REVETEMENT SELECTIF DE MATERIAUX NON CONDUCTEURS PAR DES PARTICULES DE CARBONE ET UTILISATION DE SOLUTIONS A BASE DE CUIVRE AU COURS DU PROCEDE.

Publication
EP 0581816 A1 19940209 (DE)

Application
EP 92908916 A 19920415

Priority
• DE 4113407 A 19910422
• DE 4141744 A 19911213

Abstract (en)
[origin: WO9219092A1] A method for coating non-conductors with carbon particles, comprising the following stages: a) treatment with a copper-containing solution; b) coating a non-conductor with an aqueous solution of gelatine or polyacrylate; c) rinsing with water; d) contacting with a dispersion containing carbon, a wetting agent and an ionogenic metal compound; e) rinsing with water. This method selectively produces electrically conducting surfaces, and is suitable for the direct metallization of non-conductors. After being coated with carbon, the non-conductor can be electroplated directly. The use of copper-containing solutions in the method is also described.

Abstract (fr)
Procédé de revêtement de matériaux non conducteurs par des particules de carbone, comprenant les étapes suivantes: a) traitement avec une solution à base de cuivre; b) application sur le matériau non conducteur d'une solution aqueuse de gélatine ou de polyacrylate; c) rinçage à l'eau; d) mise en contact avec une dispersion contenant du carbone, un agent mouillant et une liaison métallique ionogène, et e) rinçage à l'eau. Ce procédé permet de produire de manière sélective des surfaces électroconductrices et convient à la métallisation directe de matériaux non conducteurs. Après la phase de revêtement au carbone, le matériau non conducteur peut être galvanisé directement. L'invention concerne également l'utilisation de solutions à base de cuivre au cours du procédé.

IPC 1-7
H05K 3/42; C25D 5/54

IPC 8 full level
C25D 3/38 (2006.01); **B05D 1/18** (2006.01); **B05D 3/00** (2006.01); **B05D 5/12** (2006.01); **C25D 5/54** (2006.01); **H01B 1/22** (2006.01); **H01B 1/24** (2006.01); **H05K 3/18** (2006.01); **H05K 3/42** (2006.01); **B05D 7/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B05D 1/18 (2013.01 - EP); **B05D 3/005** (2013.01 - EP); **B05D 5/12** (2013.01 - EP); **C25D 5/54** (2013.01 - EP US); **C25D 5/56** (2013.01 - EP US); **H01B 1/22** (2013.01 - EP); **H01B 1/24** (2013.01 - EP); **H05K 3/424** (2013.01 - EP); **B05D 7/142** (2013.01 - EP); **H05K 3/427** (2013.01 - EP); **H05K 2201/0323** (2013.01 - EP); **H05K 2203/0716** (2013.01 - EP); **H05K 2203/122** (2013.01 - EP)

Citation (search report)
See references of WO 9219092A1

Designated contracting state (EPC)
AT DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9219092 A1 19921029; CA 2102240 A1 19921023; EP 0581816 A1 19940209; JP H06506984 A 19940804

DOCDB simple family (application)
DE 9200315 W 19920415; CA 2102240 A 19920415; EP 92908916 A 19920415; JP 50795292 A 19920415